

GLR1205BSI-S



250 μ m 大像素、线阵CMOS图像传感器

GLR是长光辰芯线阵芯片GL中的全新子系列，是基于长方形像素尺寸设计的线阵图像传感器。GLR1205BSI-S像素尺寸为12.5 μ m (H) x 250 μ m (V)，分辨率512(H) x 1(V)。具备高满阱、高灵敏度、高量子效率、小尺寸等特点。凭借先进的背照式工艺，GLR1205BSI-S在650nm波长下可提供近50%的量子效率,以及95%的峰值量子效率，为点激光位移传感器提供了理想的解决方案。凭借250 μ m(V)的大像素尺寸，不仅为芯片提供了高达2800ke-的满阱容量和71.1dB的最大信噪比,也提升了芯片感光灵敏度，以及便于用户在设备装调时进行光斑对准。得益于创新的像素设计，GLR1205BSI-S具备仅2.5 μ s电荷转移时间，用户无需担心lag性能。芯片采用模拟信号输出，用户可以基于MCU模块进行图像数据处理。芯片封装采用紧凑的CSP形式，封装尺寸仅为7.39mm x 1.15mm，相较于市面同类型产品尺寸更小。



产品特性

- 长方形像素
- 背照式
- 高灵敏度
- 大满阱
- CSP封装

应用领域

- 精密测量
- 食品加工
- 汽车制造

产品指标

分辨率	512(H) x 1(V)	光学尺寸	0.4"
像素尺寸	12.5 μm x 250 μm	感光面长度	6.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	95%
饱和输出电压	2.1 V	读出噪声	0.58 mV rms
暗电流	TBD	动态范围	3620: 1
最高行频	9.43 kHz	输出接口	模拟输出
最大数据率	5 MHz	通道合并	TBD
色彩	黑白	功耗	90 mW
供电电压	3.3 V	封装信息	17-pin CSP (7.39 mm x 1.15 mm)

订购信息

产品编码	描述	等级
GLR1205BSI-BBM-NQN-GBE	黑白, 无微透镜, 17 pins CSP封装, 无抗反射镀膜 密封玻璃盖板	ES

联系方式

长光辰芯 (总部)

地址: 吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号, 光电信息产业园一期5号办公楼
电话: +86-0431-85077785

长光辰芯 (杭州子公司)

地址: 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话: +86-571-87718606-888

长光辰芯 (大连子公司)

地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话: +86-0411-39937666



更多联系方式